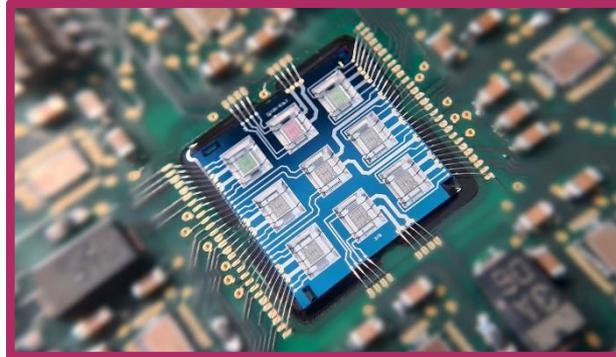


## CiS Workshop Analytik & Messtechnik

„Moderne Analytik für innovative und nachhaltige Sensorik & Materialwissenschaft“

Dienstag, 6. Juni 2023 in Erfurt

Weitere Informationen

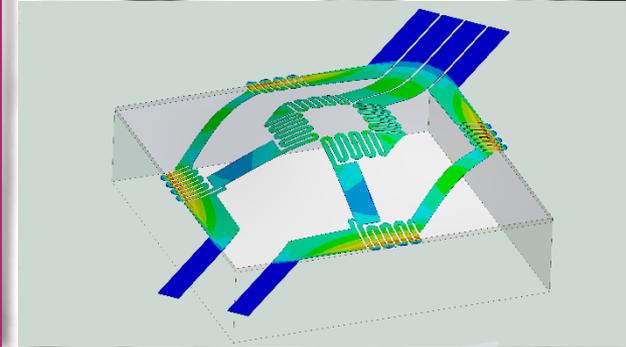


## CiS Workshop Aufbau- & Verbindungstechnik

„Aktuelle Entwicklungen in der Hybrid- und Waferlevel-Montage“

Dienstag, 12. September 2023 in Erfurt

Weitere Informationen



## CiS Workshop Simulation & Design

„Modellierung in der Mikrosystemtechnik“

Dienstag, 26. September 2023 in Erfurt

Weitere Informationen

Veranstaltungspartner / Event partner



Veranstalter / Organizer



# CiS Workshops 2023



In 2023 bieten wir **drei spannende Workshops** zu siliziumbasierter Sensorik. Informieren Sie sich über aktuelle Forschungsergebnisse sowie neuste Trends und Entwicklungen innerhalb unserer Schwerpunktthemen:

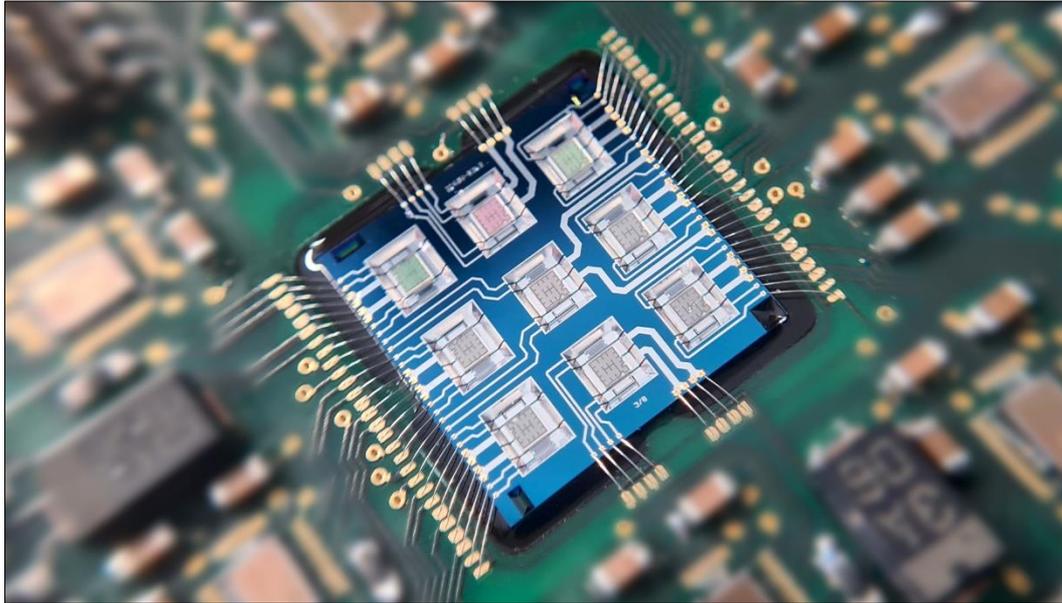
- **Analytik & Messtechnik** (06.06.2023)
- **Aufbau- & Verbindungstechnik** (12.09.2023)
- **Simulation & Design** (26.09.2023)

Nutzen Sie die Gelegenheit, Einblicke in die technischen Möglichkeiten des CiS Forschungsinstitutes zu erhalten, sich mit Experten zu vernetzen oder auch Ihre Projekte und Produkte mit einem *eigenen Beitrag* vorzustellen. Noch sind einzelne Slots frei.

Die Workshops finden als *Hybridveranstaltung* im großen Konferenzraum am CiS Forschungsinstitut in Erfurt statt. Veranstalter ist der CiS e.V.

**Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.**





## „Aktuelle Entwicklungen in der Hybrid- und Waferlevel-Montage“

Dienstag, 12. September 2023 in Erfurt

Welche Technologie erfüllt die technischen Anforderungen und bietet wettbewerbsfähige Herstellkosten? Welche neuen Möglichkeiten und Kombinationen haben sich bewährt?

Im Rahmen des Workshops werden führende Vertreter aus Industrie und Forschung in der Mikrosystem- und Halbleitertechnologie über Erfahrungen und neue Entwicklungen aus dem Bereich **Aufbau- und Verbindungstechnik** berichten. Der Blickwinkel wird auf die zuverlässige und rückwirkungsarme, spannungsoptimierte **Montage dünner Siliziumsensoren sowie optischer Hochleistungsbaugruppen** gerichtet, Vorteile einzelner Verfahren betrachtet und der Diskurs angeregt.

Die Veranstaltung bietet Raum zum Kennenlernen neuer Möglichkeiten und Vernetzen der Akteure.

# AGENDA - I



ab 8:45 **REGISTRIERUNG** & Get Together

09:15 **BEGRÜSSUNG**

Thomas Brock,  
CiS e.V. / CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH

09:30 **KEYNOTE:**

Pure play foundry technologies for advanced heterogenous system integration  
Mario von Podewils, Tino Jäger,  
X-FAB Semiconductor Foundries GmbH

10:20 Packagingkonzept und Realisierung eines time-of-flight Sensors

Alexander Grabher, Escatec Switzerland AG

10:45 State of the art and novel wafer level solder bumping for Flip chip and Chip scale packages

Daniel Lieske, AEMtec GmbH

11:10 - 11:40 **PAUSE**

11:40 Glasfritte-Bonden auf Bauteil- und Waferlevel - Technologie und Charakterisierung

André Grün, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH

12:05 Metrology requirements for bonding for advanced packaging applications

Thomas Schmidt, SÜSS MicroTec Lithography GmbH

12:30 - 13:30 **PAUSE**

13:30 Füge-technologie mit Reaktivschichtsystemen - vom Chip zum Wafer

Indira Käßlinger, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH

13:55 Localization and Characterization of Shorts in Through Silicon VIAs (TSVs)

Mario Neugebauer, X-FAB Semiconductor Foundries GmbH

14:20 - 14:50 **PAUSE**

# AGENDA - II



- 14:50    Komplette AVT Lösungen auf Wafer Ebene mittels monolithischer MEMS-CMOS Integration, Wafer Bonden und Durchkontaktierungen  
Roy Knechtel, Hochschule Schmalkalden
- 15:15    Abschlussdiskussion  
Thomas Brock,  
CiS e.V. / CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH
- 15:45    Ende des Workshops

# Allgemeine Informationen zum Workshop

## Aktuelle Entwicklungen in der Hybrid- und Waferlevel-Montage

### REGISTRIERUNG

Bitte registrieren Sie sich online auf der Internetseite:

[www.cismst.de/workshops/avt-2023/](http://www.cismst.de/workshops/avt-2023/)

Die Anmeldegebühr beträgt 150 € für die Teilnahme vor Ort inklusive Mehrwertsteuer.

Für eine online-Teilnahme werden 120 € (mehrwertsteuerfrei) fällig.

### BEZAHLUNG

Bitte überweisen Sie die Anmeldegebühr auf folgendes Konto:

**Kontoinhaber:** CiS e.V.

**Bank:** Sparkasse Mittelthüringen

**IBAN:** DE37 8205 1000 0130 1134 25

**BIC:** HELADEF1WEM

**Verwendung:** AVT2023

### ORGANISATION

Die gesamte Korrespondenz zum Workshop richten Sie bitte an folgende Adresse:

**CiS e.V.**

Uta Neuhaus  
Konrad-Zuse-Str. 14  
99099 Erfurt

**Telefon:** +49 361 663 1154

**E-Mail:** [veranstaltung@cismst.de](mailto:veranstaltung@cismst.de)



### VERANSTALTUNGSORT

**CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik**  
Konrad-Zuse-Str. 14  
99099 Erfurt

Sie reisen nach Erfurt ...

...mit dem **Auto** via Autobahn A71 und/oder A4, Ausfahrt Erfurt Ost

...mit dem **Zug** zum Erfurter Hauptbahnhof und dann Straßenbahn Linie 3

Der Workshop findet im großen Konferenzraum im 3. OG statt.

Linie 3, Richtung "Urbicher Kreuz", bis Haltestelle "Windischholzhausen/ X-Fab" bis zu Fuß bis zum CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH (Gebäude siehe Foto)

# IHRE ANREISE ZUM CiS FORSCHUNGSIINSTITUT

- Auto** A4 oder A71
- Bahn** Erfurt Hauptbahnhof, Straßenbahn Linie 3
- Flugzeug** Flughafen Erfurt Weimar (ERF)

